



### 주요 특징

- 최적의 성능 및 처리 기능을 저렴하게 제공
- 대용량 스토리지 제공, 필요할 때 확장할 수 있는 유연한 구성
- 효율적 설계로 관리가 간편하며 에너지 비용도 절감



## IBM System x3400 M3

성장하는 비즈니스를 운영하기에 적합한 유연하고 효율적인 타워 서버

### 지속 가능한 투자로 IT 목표 달성

IBM System x3400 M3은 최신 Intel® Xeon® 프로세서 및 메모리 용량을 활용하여 처리 성능 및 유연성이 향상되었습니다. 비용 최적화된 RAID 기술, 메인프레임급 안정성, 추가 메모리를 제공하는 x3400 M3은 가상화 및 기타 집약적 애플리케이션에 대해 비용당 더욱 우수한 성능을 제공합니다.

### 유연한 업그레이드로 적절하게 확장

x3400 M3은 유연한 구성 옵션을 제공하므로 비즈니스가 성장하면 쉽게 확장할 수 있습니다. 높은 스토리지 용량을 제공하고 스토리지 인터페이스를 선택할 수 있으므로 고객은 필요할 때 비즈니스를 전환할 수 있습니다. 현재의 하드 디스크 드라이브 크기, 용량 및 성능에 맞는 적절한 조합을 선택한 후 향후에 쉽게 추가할 수 있습니다.

### 에너지 및 관리 비용 절약

x3400 M3은 효율적인 설계에 저전압 메모리를 장착했고 에너지 구성 요소를 관리하는 도구를 제공하므로 전력 소비량 및 비용을 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다. 또한 광범위한 시스템 관리 기능을 즉시 사용할 수 있으므로 관리 시간 및 비용이 절약됩니다.

x3400 M3의 선택 구성은 IBM Express Advantage™ Portfolio의 일부이며 중견기업의 요구사항에 맞게 설계되었습니다. 관리가 용이한 Express™ 모델과 구성은 국가별로 다양합니다.





## IBM System x3400 M3 개요

폼 팩터/높이	타워/5U(랙 탑재형)
프로세서(최대)	4코어 Intel Xeon E5640 2.66 GHz 및 프로세서 소켓당 12 MB 캐시(기본) 또는 6코어 Intel Xeon X5670 2.93 GHz 및 프로세서 소켓당 12 MB 캐시(주문형 사양 구성을 통해서만 사용 가능)
프로세서 개수(표준/최대)	1/2
캐시(최대)	프로세서 소켓당 4 MB 또는 12 MB
메모리(최대)	16 DIMM 슬롯(최대), 128 GB, DDR-3 1,333 MHz RDIMM 사용 <sup>1</sup> 또는 48 GB, DDR-3 1,333 MHz UDIMM 사용 <sup>1</sup>
확장 슬롯	5개의 PCI-e 및 1개의 PCI(기본), 추가로 2개의 PCI-X 또는 1개의 PCI-e(주문형 사양 구성으로만 가능)
디스크 베이(총계/핫스왑)	4개의 3.5" 심플스왑형 SATA(Serial ATA) 또는 3.5" 핫스왑형 SATA/SAS(Serial Attached SCSI) HDD(기본) 또는 8개나 16개의 2.5" 핫스왑형 SAS HDD. 8개의 3.5" 핫스왑형 SAS/SATA HDD(모델에 따라 다름).
최대 내장 스토리지	3 TB의 3.5" 심플스왑형 SATA HDD; 8 TB의 3.5" 핫스왑형 SATA HDD; 4.8 TB의 3.5" 핫스왑형 SAS HDD; 또는 8 TB의 2.5" 핫스왑형 SATA/SAS HDD(모델에 따라 다름)
네트워크 인터페이스	내장 듀얼 기가비트 이더넷
전원 공급 장치(표준/최대)	920 W(1/2) 또는 670 W(1/1)(모델에 따라 다름)
핫스왑형 구성요소	팬 및 하드 디스크 드라이브(기본), 전원 공급 장치(모델에 따라 다름)
RAID 지원	6 Gbps 또는 3 Gbps RAID-0, -1, -1E 내장(모델에 따라 다름), 옵션으로 RAID-10, -5, -50, -6, -60
시스템 관리	내장 시스템 관리 프로세서
지원되는 운영 체제	Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Red Hat Linux®, SUSE Linux, VMware ESX Server; 하이퍼바이저 키 내장
보증	3년 고객 교체 가능 유닛(CRU) 및 현장 제한 보증

© Copyright IBM Corporation 2010

IBM Systems and Technology Group  
Route 100  
Somers, New York 10589

Produced in the United States of America  
2010년 3월  
All Rights Reserved

IBM, IBM 로고, ibm.com 및 System x는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 이러한 또는 다른 IBM 상표 용어가 상표 기호(® 또는 ™)와 함께 정보에 처음 표시된 경우, 이런 기호는 IBM이 해당 정보를 출판할 당시 소유한 미국 등록 상표 또는 보통법 상표를 나타냅니다. 그런 상표는 또한 다른 국가에서도 등록 상표 또는 보통법 상표일 수 있습니다. 현재 IBM 상표 목록은 다음 웹사이트인 "저작권 및 상표 정보"에서 확인할 수 있습니다.  
[ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://ibm.com/legal/copytrade.shtml)

Intel 및 Intel Xeon은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation 또는 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

다른 제품, 회사 또는 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스 마크입니다.

<sup>1</sup> 2010년 2분기에 8 GB DIMM을 출시하면 RDIMM은 최대 128 GB를 지원하고, 2010년 2분기에 4 GB DIMM을 출시하면 UDIMM은 최대 48 GB를 지원합니다.



재활용하십시오

## 추가 정보

U.S. [ibm.com/systems/x/](http://ibm.com/systems/x/)

캐나다 [ibm.com/systems/ca/en/servers/x/index.html](http://ibm.com/systems/ca/en/servers/x/index.html)